

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 27 年 3 月 5 日 (2015.3.5)

【公開番号】特開 2013-187313 (P2013-187313A)

【公開日】平成 25 年 9 月 19 日 (2013.9.19)

【年通号数】公開・登録公報 2013-051

【出願番号】特願 2012-50719 (P2012-50719)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

H 0 5 K 3/24 (2006.01)

H 0 5 K 3/18 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/02 Q

H 0 5 K 1/02 F

H 0 5 K 3/24 A

H 0 5 K 3/18 N

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 1 月 15 日 (2015.1.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁基板と、

前記絶縁基板の一方の面に形成される配線層と、

前記絶縁基板の一方の面と他方の面との間を貫通する第 1 貫通孔内に形成され、前記配線層に接続される第 1 ピアと、

前記配線層及び前記第 1 ピアから離間して前記絶縁基板の一方の面に形成されるバスラインと、

前記絶縁基板の一方の面と他方の面との間を貫通する第 2 貫通孔内に形成され、前記バスラインに接続される第 2 ピアと

を含む、配線基板。

【請求項 2】

前記絶縁基板の他方の面側において前記第 1 ピア及び前記第 2 ピアを電氣的に接続した状態で前記バスラインに給電を行うことによって前記配線層の表面に形成される、めっき層をさらに含む、請求項 1 記載の配線基板。

【請求項 3】

前記絶縁基板の一方の面には、前記配線基板を個片化した後の複数の配線基板片に対応し、それぞれに前記配線層が形成される配線形成領域が複数設けられており、

前記バスラインは、前記複数の配線形成領域の周囲を囲むように設けられている、請求項 1 又は 2 記載の配線基板。

【請求項 4】

前記配線層及び前記第 1 ピアと、前記バスライン及び前記第 2 ピアとは、互いに電氣的に分離されている、請求項 1 乃至 3 のいずれか一項記載の配線基板。

【請求項 5】

一方の面に配線層が形成されるとともに、前記一方の面と他方の面との間を貫通する第

1 貫通孔内に前記配線層に接続する第 1 ピアが設けられた絶縁基板の、前記他方の面において、前記第 1 ピアに金属シートを当接させる工程と、

前記金属シートを介して前記第 1 ピア及び前記配線層に給電を行う電解めっきにより、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程と
を含む、配線基板の製造方法。

【請求項 6】

前記絶縁基板は、前記配線層及び前記第 1 ピアから離間して前記一方の面に形成されるバスラインと、前記一方の面と前記他方の面との間を貫通する第 2 貫通孔内に形成され、前記バスラインに接続される第 2 ピアとをさらに含んでおり、

前記第 1 ピアに金属シートを当接させる工程では、前記金属シートは前記第 2 ピアにも当接されており、

前記めっき層を形成する工程は、前記バスラインに給電を行うことにより、前記第 2 ピアを介して前記金属シートに給電を行いながら、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程である、請求項 5 記載の配線基板の製造方法。

【請求項 7】

前記配線層の表面にめっき層を形成する工程は、前記金属シートに給電を行いながら、スパージャ方式で、前記配線層の表面にめっき層を形成する工程である、請求項 5 記載の配線基板の製造方法。

【請求項 8】

前記配線層の一部を端子として露出する絶縁層を前記配線層の上に形成する工程をさらに含む、請求項 5 乃至 7 のいずれか一項記載の配線基板の製造方法。